



應加速改善場址媒合場址公開資訊

03 鴻達電子股份有限公司

縣市別	桃園市		
場址地號	桃園市楊梅區頭重溪段一七之二七地號； 桃園市楊梅區頭重溪段一七之四九地號； 桃園市楊梅區頭重溪段一七之五〇地號		
場址地址	桃園市楊梅區新農街二段二零九巷八一號		
場址座標	267000, 2756411		
場址面積 (m ²)	1,952	都市計畫區	楊梅都市計畫
土地類別	皆為私有地	使用分區	農業區
列管狀態	公告為控制場址	使用地類別	-
土壤污染物	鉛、銅		
地下水污染物	-		
預估整治經費	200萬元 (8個月)		
現況描述	原先由鴻達電子股份有限公司使用，已停止生產運作，後被 法拍，現場僅有廠房建築，為無人使用的廢棄狀態。		

場址範圍圖



場址現況圖

